

信頼性試験結果

Reliability Test

XC9223Bシリーズ /1MHz品 (ドライバ Tr.内蔵1A 降圧DC/DCコンバータ)

XC9223B Series/1MHz (1A Driver Transistor Built In Step-Down DC/DC Converter)

パッケージ : USP-10B
Package

RoHS対応品 RoHS Compliance

ハロゲン/アンチモンフリー Halogen & Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	125°C VIN=6.3V	1000	0/22
2	高温保存 High Temperature Storage	150°C	1000	0/22
3	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VIN=6.3V	1000	0/22
4	温度サイクル Temperature Cycle (Gaseous)	-55°C~125°C 各30分 30min Each	100CYC.	0/22
5	プレッシャークッカーバイアス HAST	125°C85%RH VIN=6.3V 2×10 ⁵ Pa	100	0/22
6	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	30°C70%RH336H→reflow(150°C~170°C94秒/peak260°C)1回 30°C70%RH168H→reflow(150°C~170°C94秒/peak260°C)1回 IPC/JEDEC J-STD-020D 準拠		0/110
7	静電耐圧 Electric Static Discharge.	R=0Ω C=200pF ±200V以上 各端子3回 ±200V over 3times Each R=1500Ω C=100pF ±1kV以上 各端子3回 ±1kV over 3times Each		0/20
8	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V以上 各端子3回 ±100V over 3times Each 50mA以上 50mA over		0/5

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	試験結果 Result r/n	
1	接合強度試験 Adhesive strength test	PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403) apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec.	0/5	パッケージ代表データ
2	基板反り試験 Bending Test	たわみ量 5mm 5±1s 1回/1times (EIAJ ED4702) Strain	0/5	Performed with samples that represent the applicable PKG type.
3	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒(プロファイル昇温法) 10s (Temperature profile method)	0/11	